

【証券コード：6728】

決算説明会資料

2015年度（2015年7月～2016年6月）

2016年8月12日
株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ（FPD）・半導体・太陽電池・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

（特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです）

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q（累計）： 第2四半期連結累計期間

2Q： 第2四半期連結会計期間

2015年度連結業績概要

2015年度連結業績概要

2016年度
連結業績予想

中期経営計画の進捗

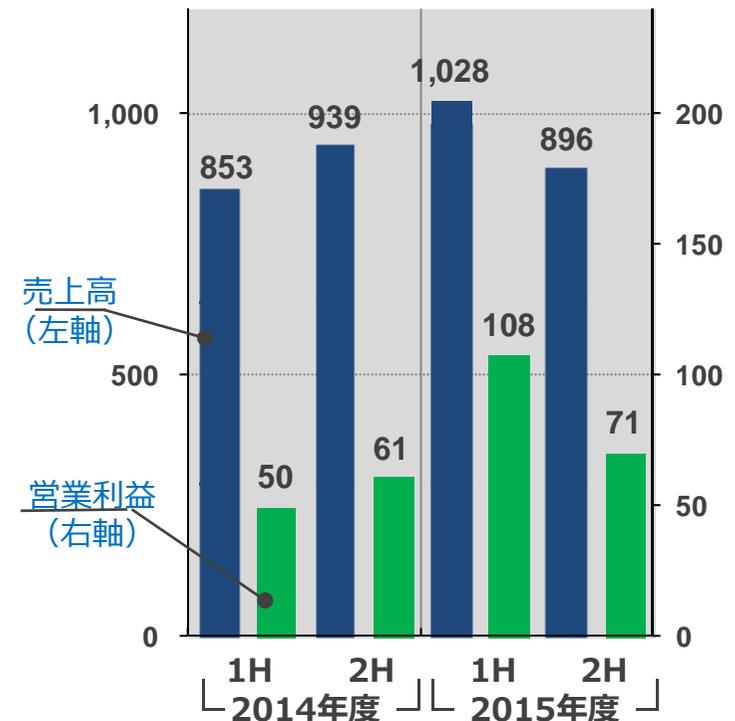
市場環境と
アルバックの取組み

- 受注高・売上高：FPD製造装置を中心に前年度比増加。特に受注高は、16年度に見込んでいた中国の大型液晶パネル向け製造装置が下期に前倒し受注となった影響もあり、大幅に増加（前年度比22%増加）。
- 営業利益：売上高の増加に加え、利益率の上昇により前年度比60%増加の179億円。なお、4Qの減少は、売上高の一時的な減少及び特殊要因（長期未回収の個別案件での12.8億円の貸倒引当実施）による一過性のもの。
- 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は、いずれも過去最高益。

【単位：億円】

	2014年度 実績	2015年度 実績	前年度比
受注高	1,827	2,236	409 (+22%)
期末受注残高	730	1,013	
売上高	1,792	1,924	133 (+7%)
営業利益	111	179	67 (+60%)
率	6.2%	9.3%	
経常利益	125	184	59 (+47%)
率	7.0%	9.5%	
親会社株主に帰属 する当期純利益	89	167	78 (+88%)
率	5.0%	8.7%	

売上高と営業利益の推移（半期毎）



2015年度連結業績概要 (利益率の推移)

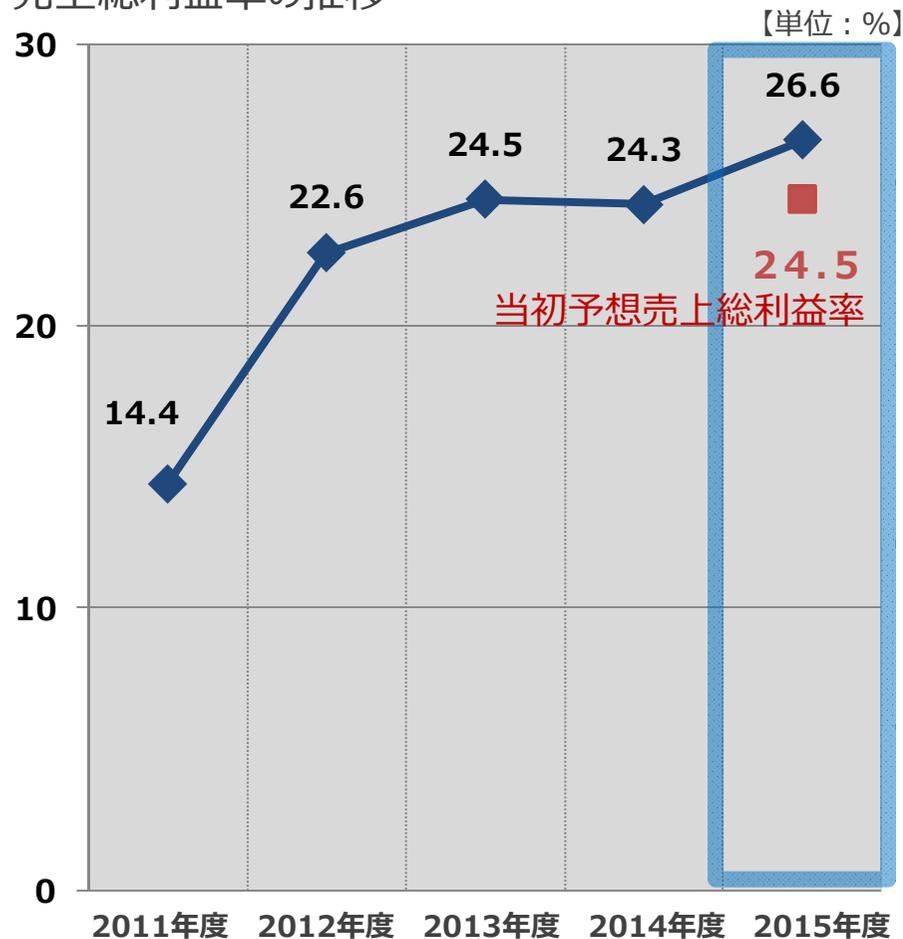
2016年度
連結業績予想

中期経営計画の進捗

市場環境と
アルバックの取組み

製造コスト削減が当初予想を上回ったこと、比較的収益性の高い案件が寄与したことに加え、売上高の増加もあり、売上総利益率・営業利益率ともに上昇。

売上総利益率の推移



営業利益率の推移



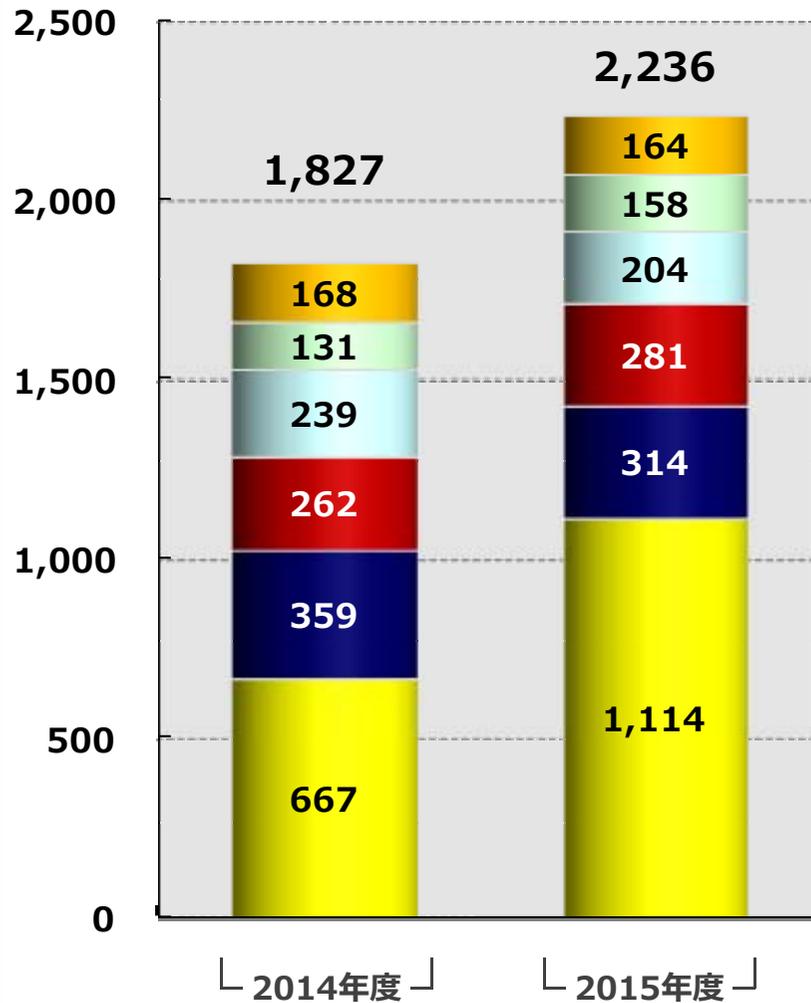
2015年度連結業績概要 (品目別受注高の実績)

2016年度
連結業績予想

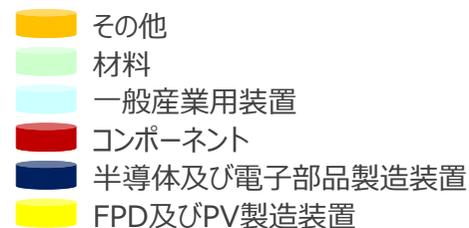
中期経営計画の進捗

市場環境と
アルバックの取組み

【単位：億円】



- FPD製造装置は、中国の大型液晶パネル向け製造装置の設備投資前倒し受注や、有機EL（OLED）投資の活発化により大幅に増加。
- 半導体及び電子部品製造装置は、スマートフォン販売台数の伸びの低下に伴う設備投資減少の影響やDRAM投資が縮小したこと、不揮発性メモリ製造装置の一時的な投資先延ばしもあり、前年同期比減少。
- コンポーネントは、韓国でのクライオポンプの大型受注が15年度4Qに集中したことにより、前年同期比増加。
- 一般産業用装置は、中国市場における自動車向け機器等の停滞により、前年同期比減少。
- 材料は、FPD用ターゲット材の増加により、前年同期比増加。
- 「その他」は、大きな変動は無し。



2015年度連結業績概要 (品目別売上高の実績)

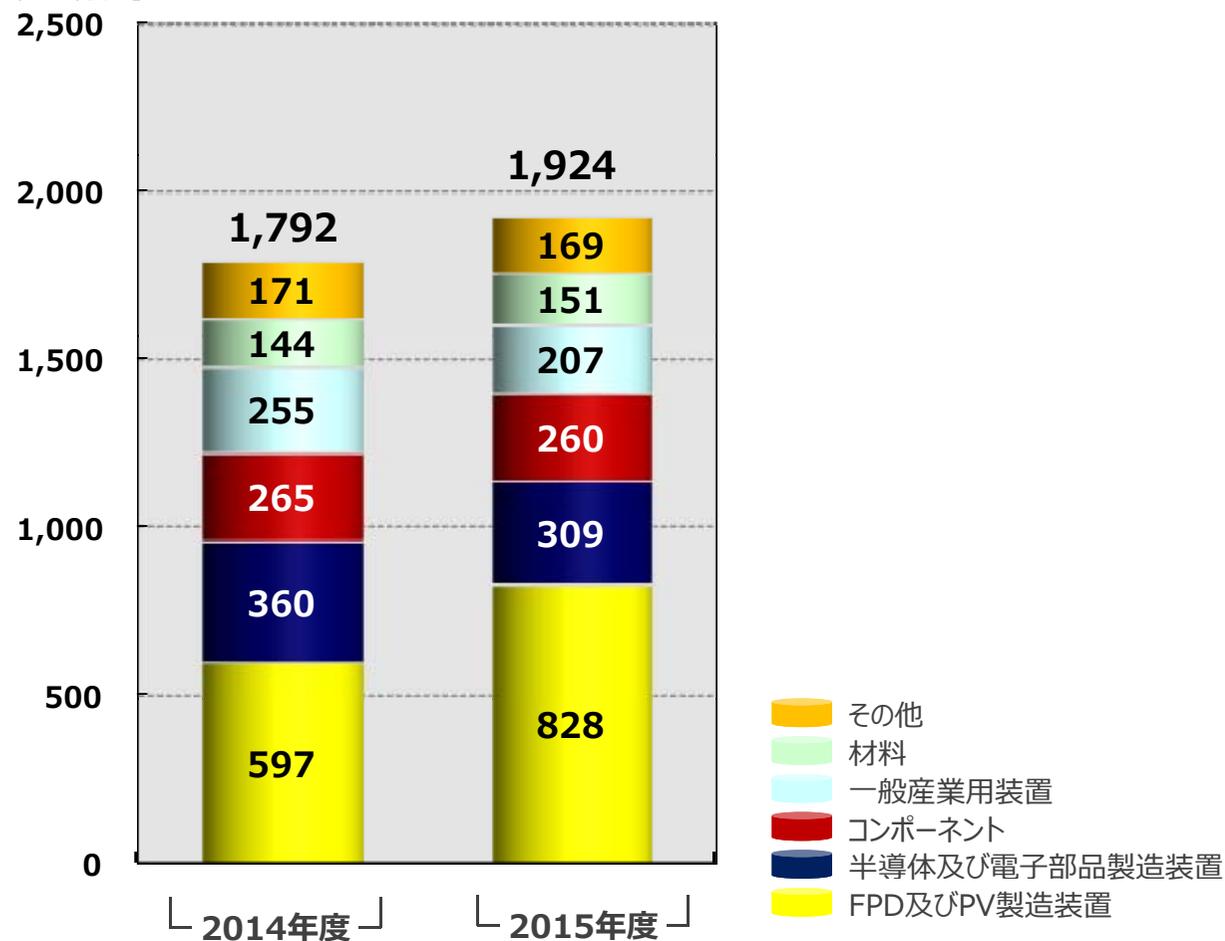
2016年度
連結業績予想

中期経営計画の進捗

市場環境と
アルバックの取組み

14年度から15年度にかけての受注推移を受けて、主に、FPD及びPV製造装置が増加、半導体及び電子部品製造装置、一般産業用装置は減少。

【単位：億円】



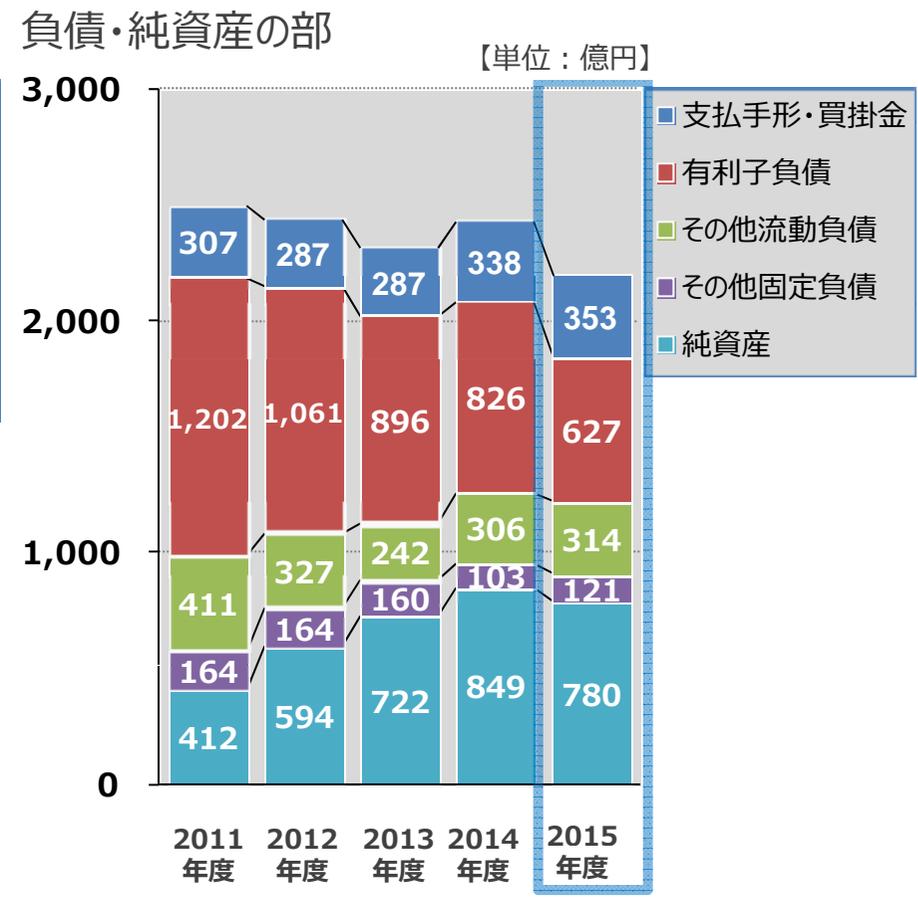
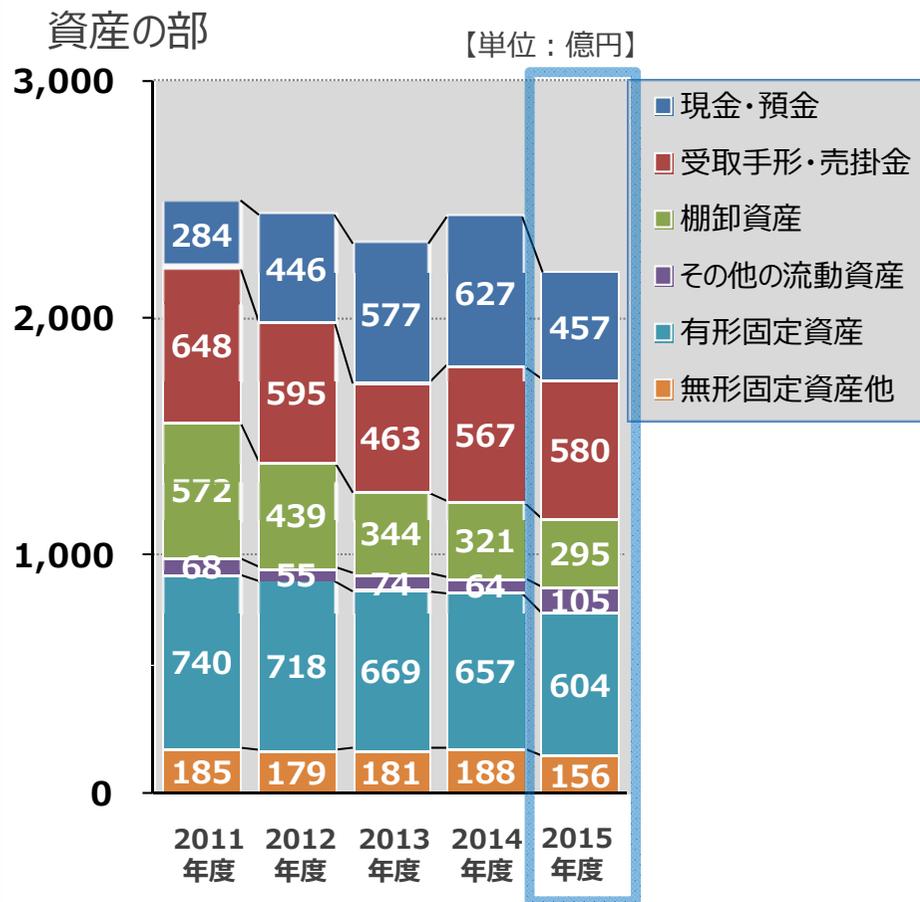
2015年度連結業績概要 (連結貸借対照表)

2016年度
連結業績予想

中期経営計画の進捗

市場環境と
アルバックの取組み

- 有利子負債は前年度比約200億円減少。
- 優先株は残存部分（元本100億円）を全額償還。
- バランスシートは全体としてスリムに。



2015年度連結業績概要 (キャッシュ・フローと有利子負債の実績)

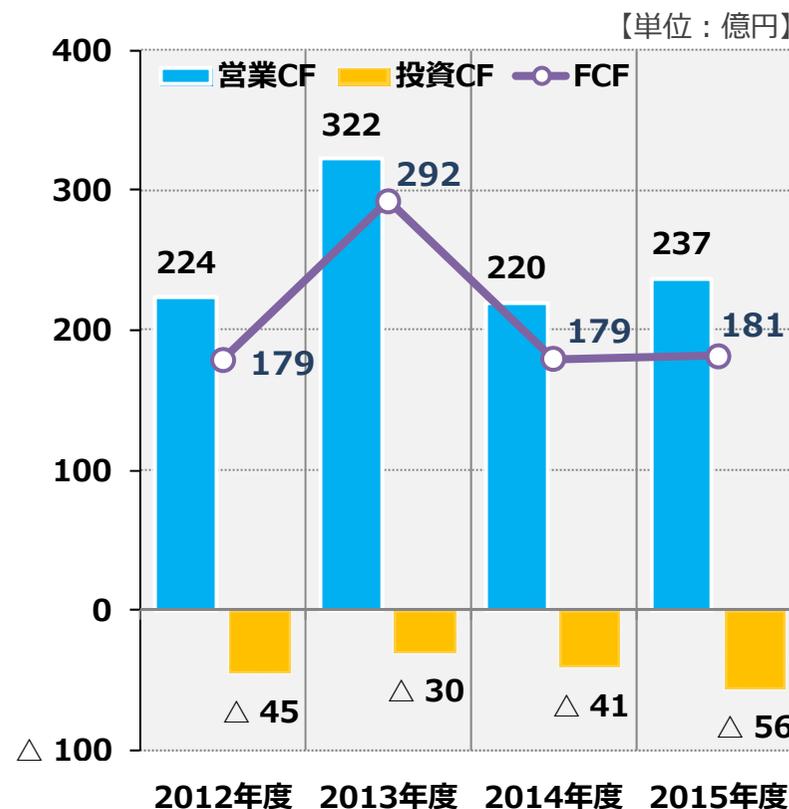
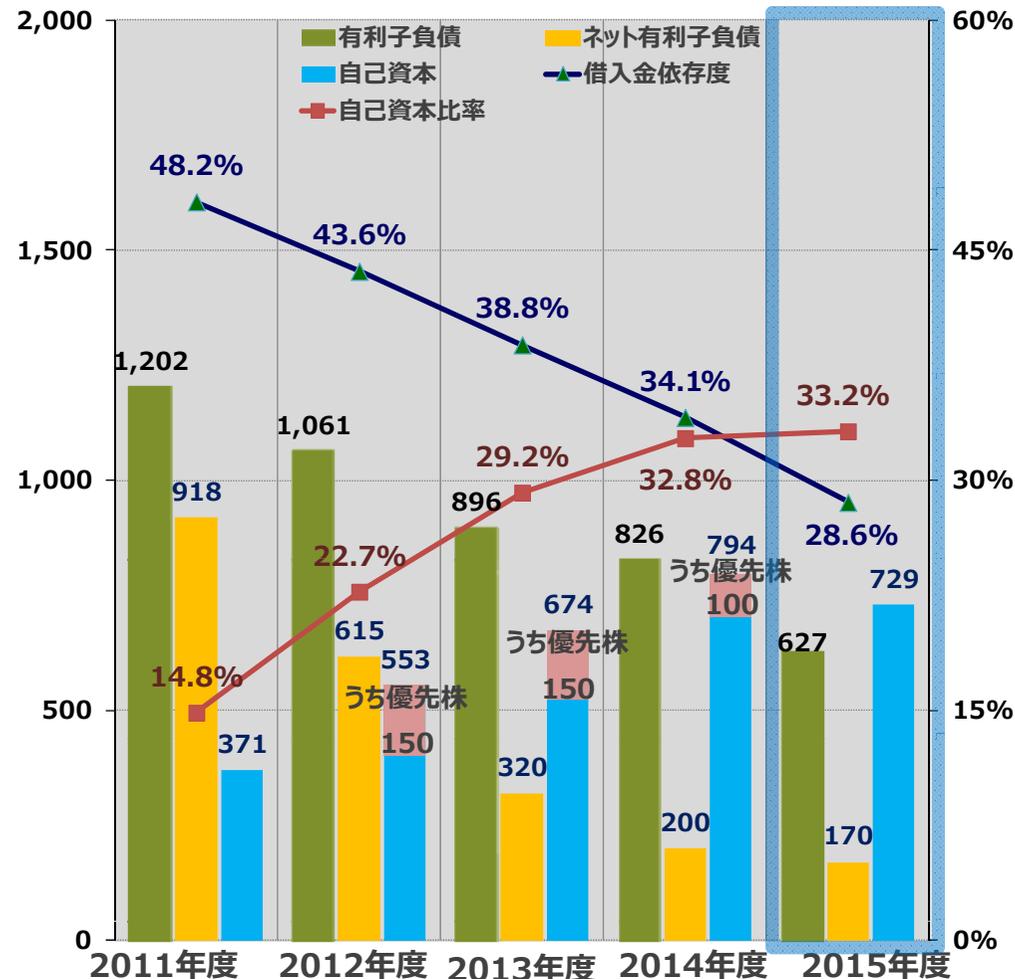
2016年度
連結業績予想

中期経営計画の進捗

市場環境と
アルバックの取組み

- 残存する優先株を全額償還。その上で自己資本比率は33.2%に改善。また、借入金依存度は28.6%に改善。ネット有利子負債は170億円に減少。
- 営業CFは前年度比増加、投資CFの増加をカバーし、FCFも前年度比増加。

【単位：億円】



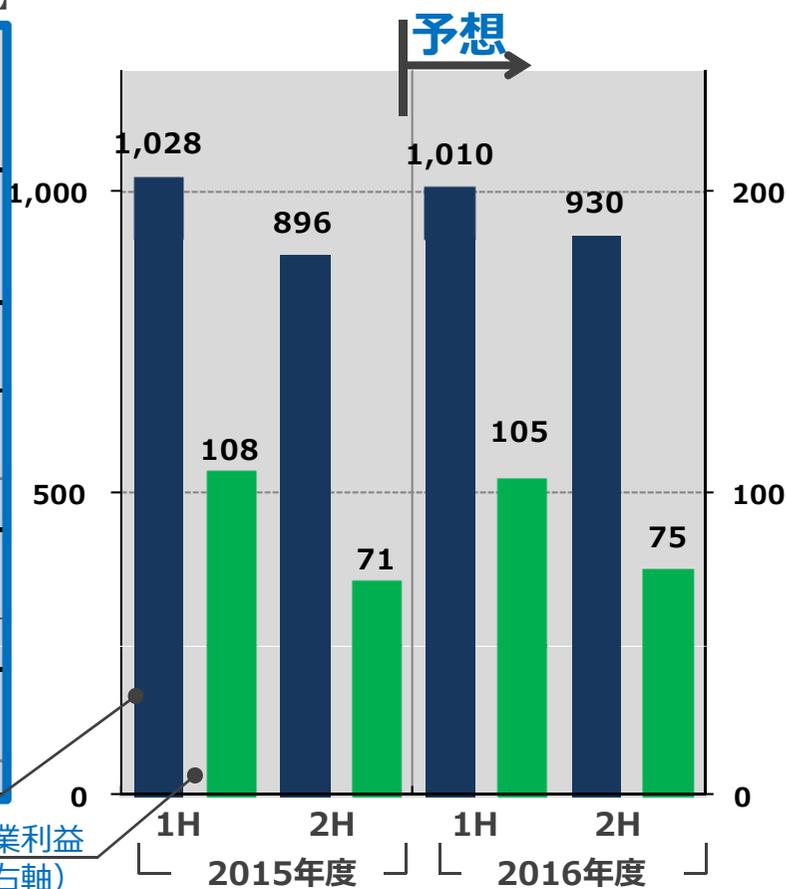
2016年度連結業績予想

- 受注高・売上高：受注高は、FPDで有機EL向けは増加、ただし大型液晶パネル向けの反動（前年度下期に集中）を見込んでいることから、全体では前年度比減少を予想（2015・2016年度を平均してみれば、年間2,050億円レベル）。売上高は、受注残等勘案、増加を予想。
- 営業利益は、今後の市場の拡大が予想される有機EL関連の開発コストの増加等を見込むが、前年度並みは確保を予想。

【単位：億円】

売上高と営業利益の推移（半期毎）

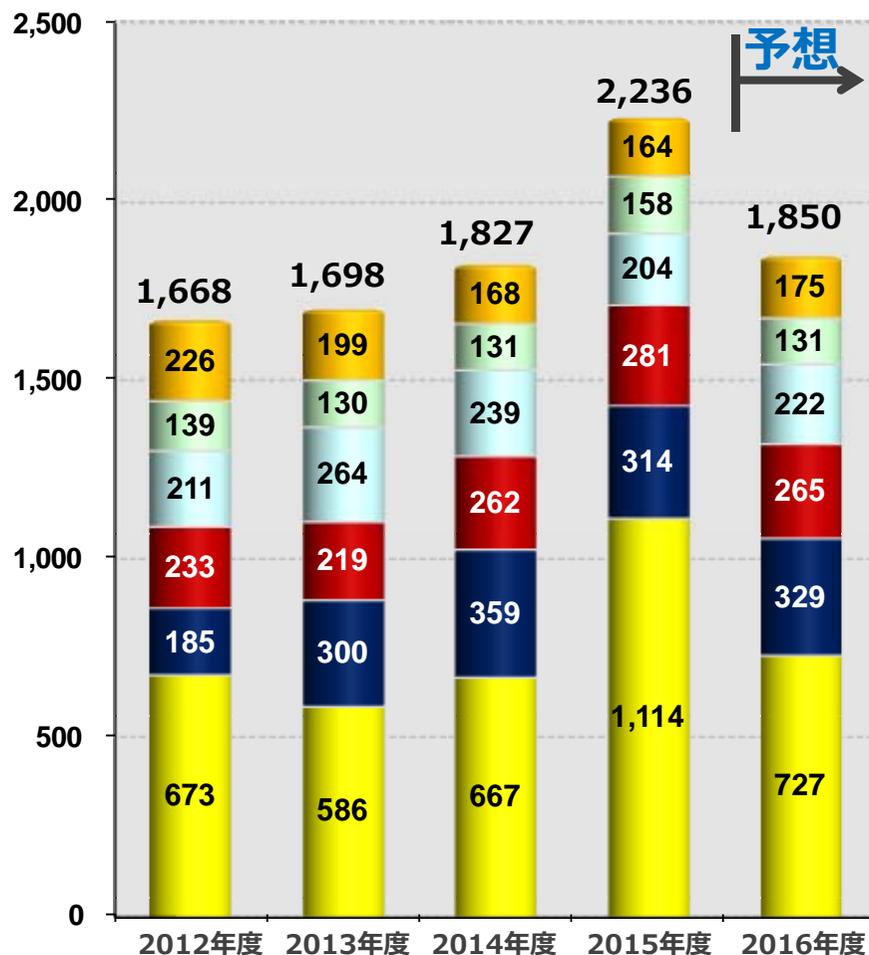
	2015年度 実績	2016年度予想		
		2Q (累計)	通期	前年度比
受注高	2,236	930	1,850	△ 386 (△17%)
期末受注残高	1,013	933	923	
売上高	1,924	1,010	1,940	16 (+1%)
営業利益	179	105	180	1 (+1%)
率	9.3%	10.4%	9.3%	
経常利益	184	105	180	△ 4 (△2%)
率	9.5%	10.4%	9.3%	
親会社株主に帰属 する当期純利益	167	75	120	※ △ 47 (△28%)
率	8.7%	7.4%	6.2%	



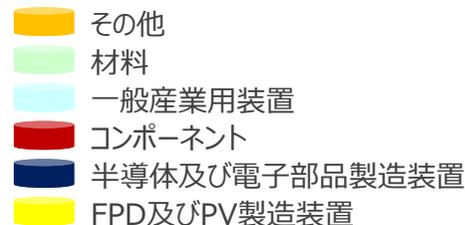
※15年度は繰延税金資産を計上したことで、一時的に税金費用が減少したが、16年度はこうした要因がなくなるため。

- ① FPD製造装置は前年度の前倒し受注の反動により、② コンポーネントも有機EL関連のクライオポンプの前年度大口受注の反動により、③ 材料は面積需要が増加するも価格競争により、それぞれ減少を見込む。
- 半導体及び電子部品製造装置や一般産業用装置は増加を見込む。

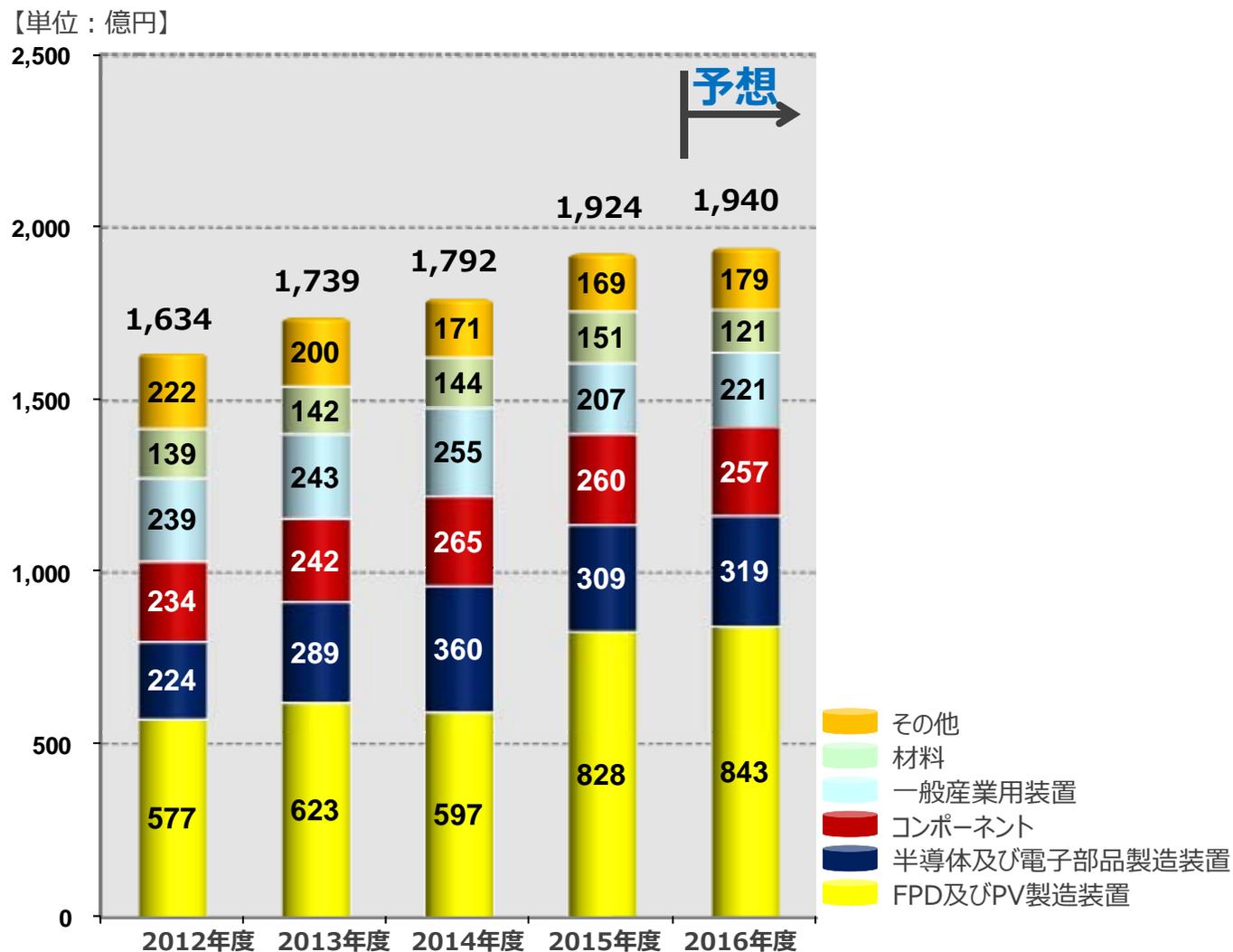
【単位：億円】



- FPD製造装置は、有機EL関連のウェイトが高いと見込む。
- 半導体及び電子部品製造装置は、3D-NANDや不揮発性メモリ、パワー半導体、電子実装、通信用モジュール、センサー、EMIシールドなどの伸びを見込む。
- 「その他」は、高性能マスクブランクスへの伸びを見込む。

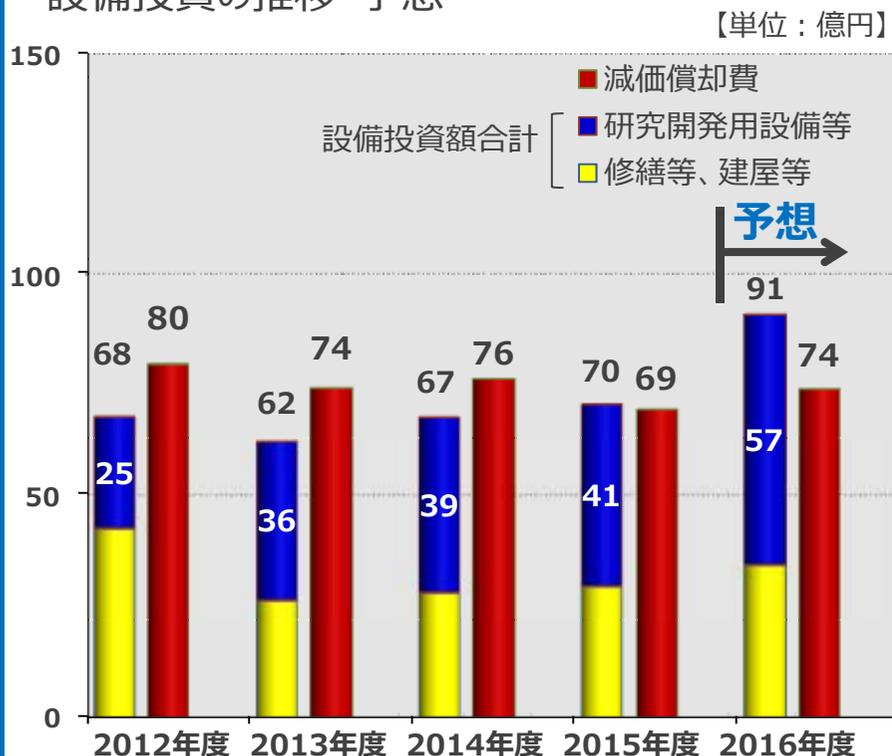


FPDの受注高は2015年度比減少するが、期首受注残高の増加により、売上高は2015年度を上回る見込み。

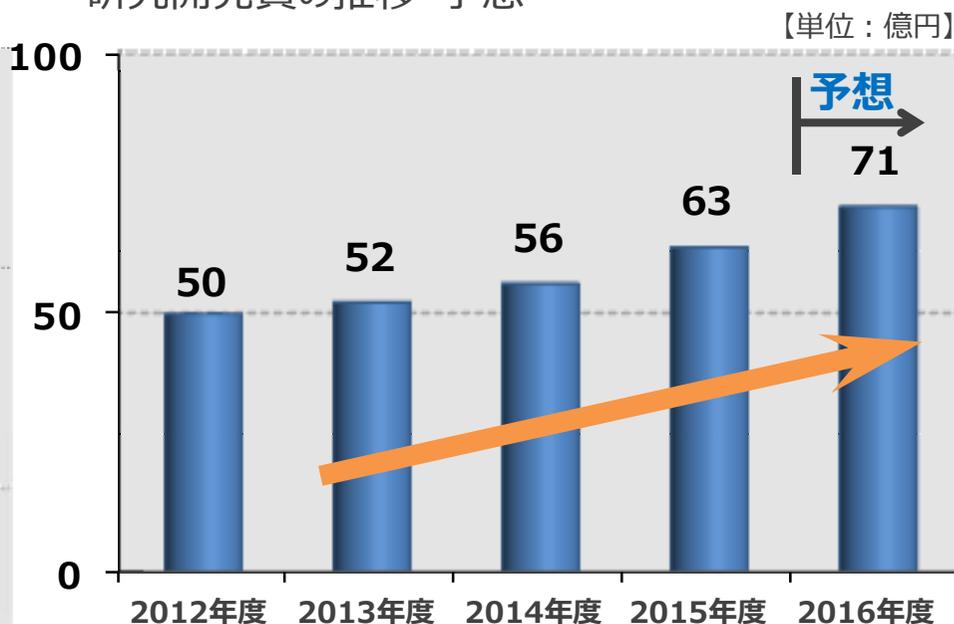


研究開発用設備投資・研究開発費ともに、継続的に増加。
有機ELや不揮発性メモリなどへの取組みに加え、将来的な成長につながる開発も積極化。

設備投資の推移・予想

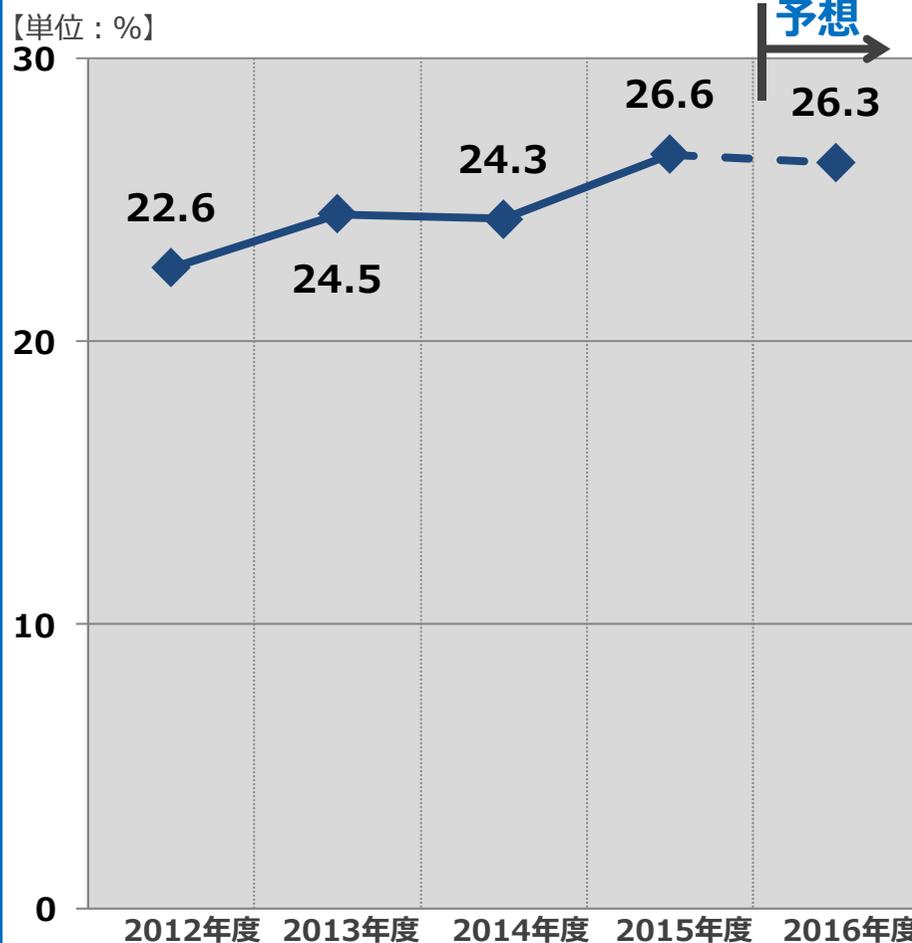


研究開発費の推移・予想

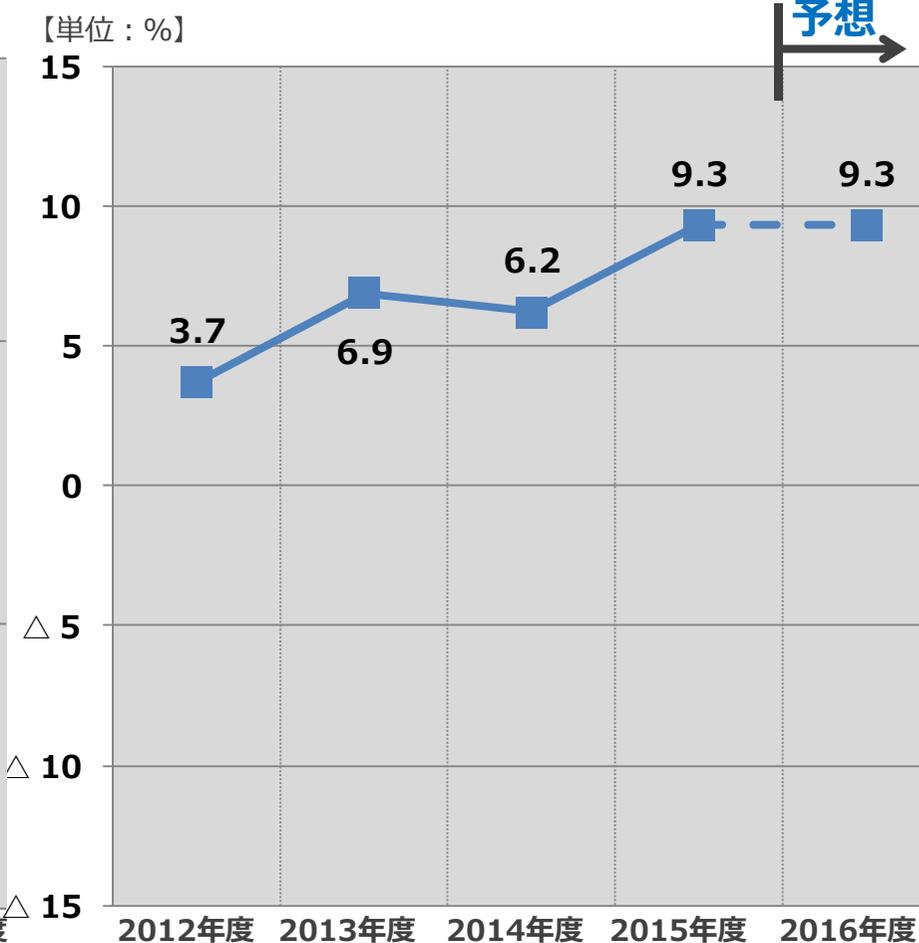


有機ELなど将来に向けた開発要素の高い装置の売上比重が増加するが、利益率は概ね前年度並みを確保。

売上総利益率の推移

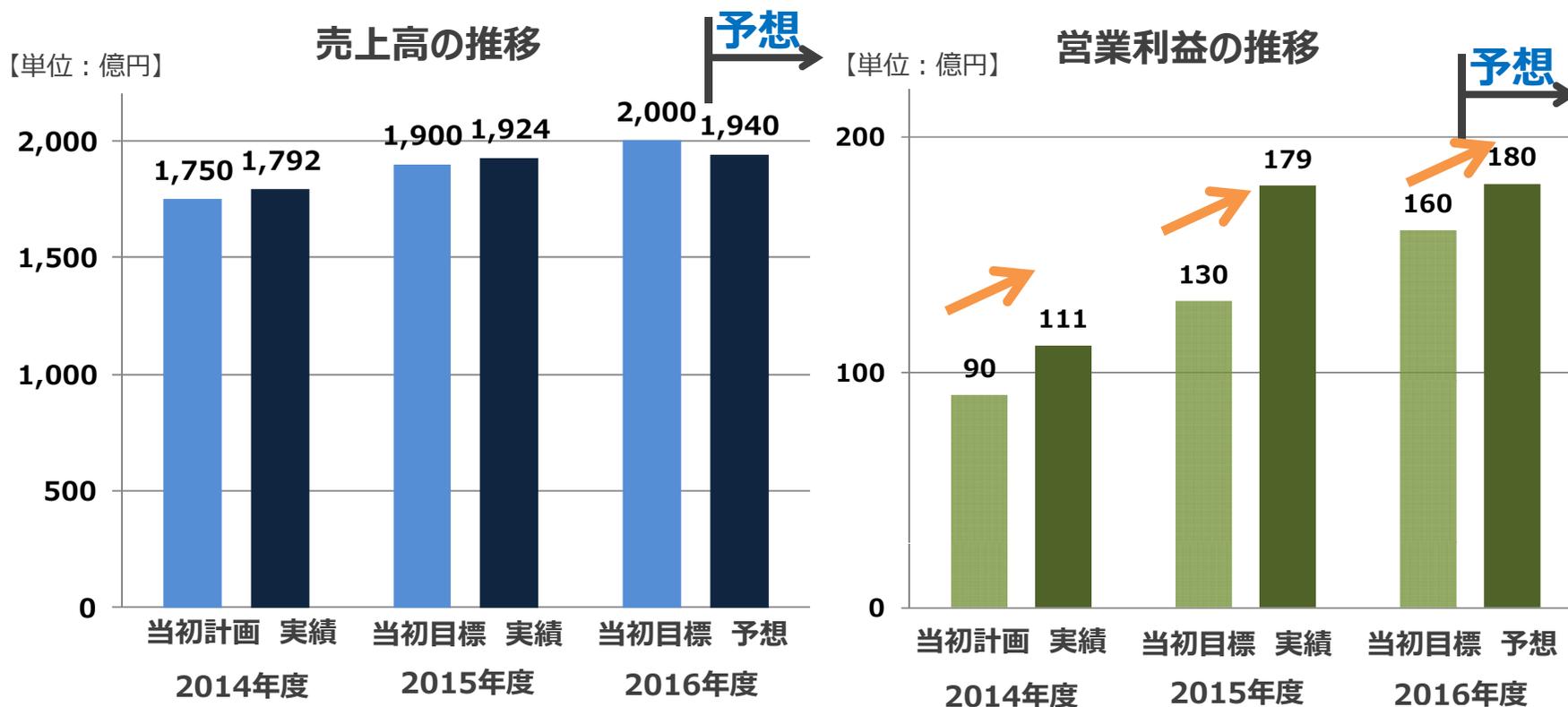


営業利益率の推移



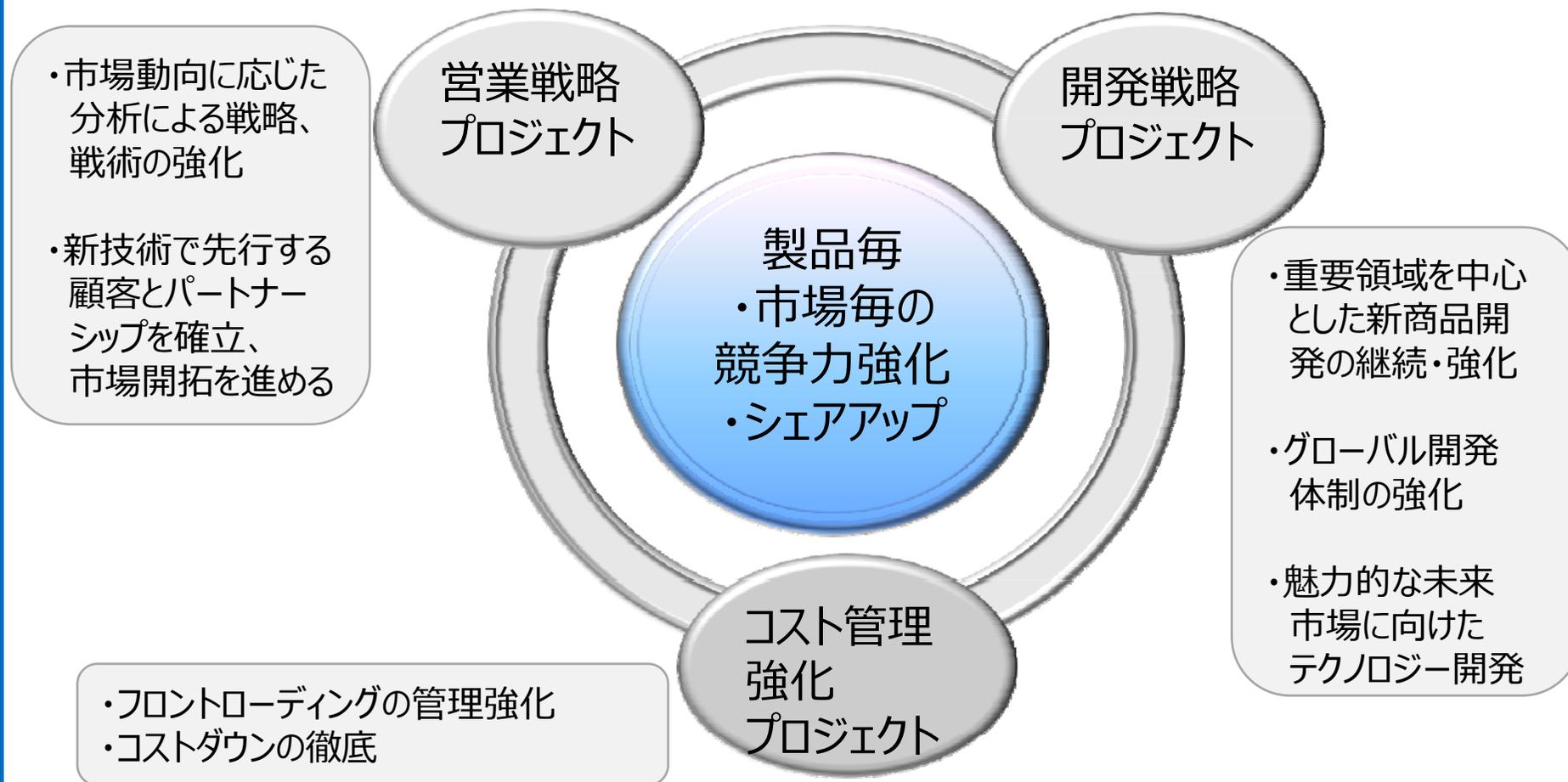
中期経営計画の進捗

- 現中期経営計画1年目（2014年度）、2年目（2015年度）は、いずれも当初の計画を上回る実績。
- 最終年度となる2016年度についても、引き続き当初利益目標を上回る予想。



現中期経営計画達成に向けたプロジェクトの取組み

- ・現中期経営計画の基本方針・事業領域に関する基本シナリオは堅持。



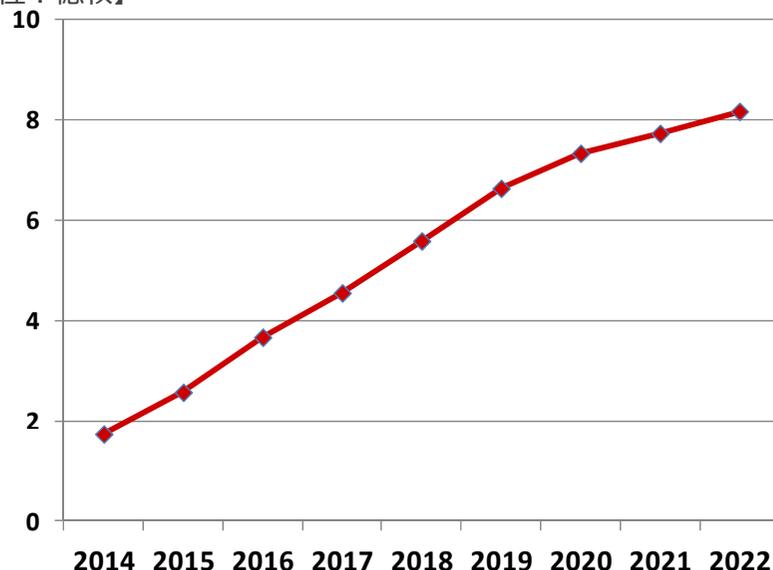
市場環境とアルバックの取組み

FPD市場（有機EL）：市場の成長とアルバックの取組み

- ・スマートフォン向けパネルは有機ELが増加の予想（出荷金額は2018年に液晶パネル上回る予想）。
⇒有機EL投資の動きが加速化
- ・蒸着装置・スパッタ装置・CVD装置といった真空装置やコンポーネントなど、有機EL製造における、幅広い顧客ニーズに応えることの出来る製品ラインナップで対応。

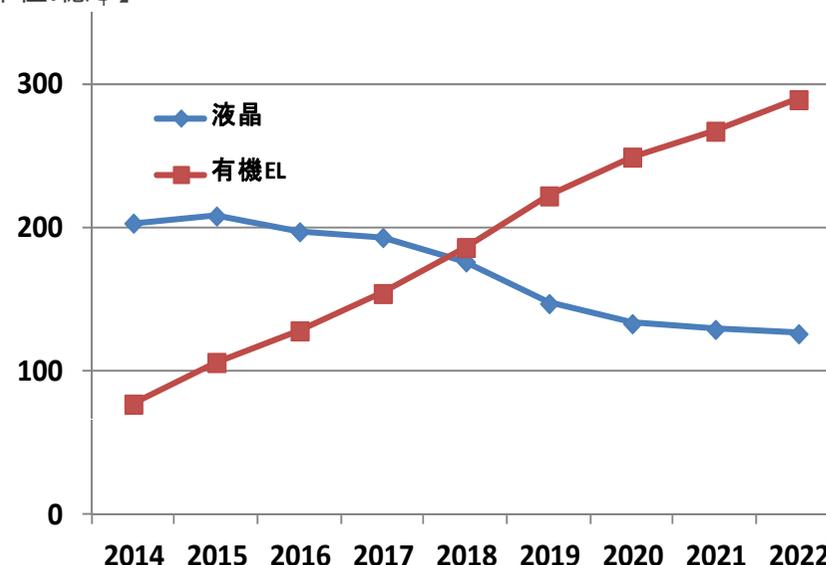
スマートフォン向け有機ELパネル出荷枚数

【単位：億枚】



スマートフォン向けパネル出荷額

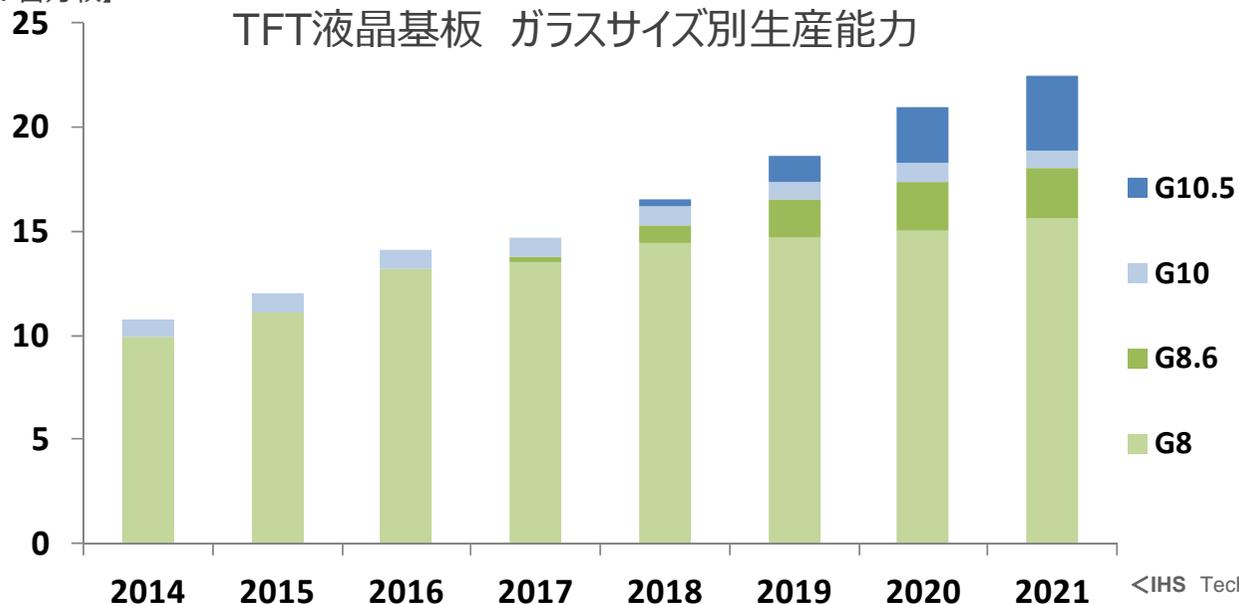
【単位：億\$】



<IHS Technology資料から作成>

FPD市場（液晶）：大型化の動きとアルバックの取組み

【単位：百万枚】



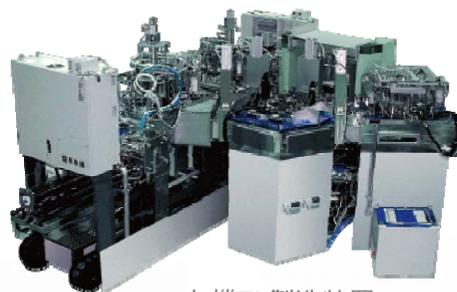
- ・今後の大型TV向け設備投資は中国が中心。
- ⇒大型TV向けパネル製造用スパッタリング装置の中国生産を開始

2016年7月
大型TV向け装置生産開始記念式典（中国蘇州にて）
現地マスメディアも参加、注目を集めた



FPD製造全般におけるアルバックの取組み

・アルバックの総合力を生かし、LCDや有機EL向けに、成膜装置、コンポーネント、材料を提供。



有機EL製造装置
ZELDAシリーズ



水晶発振式成膜
コントローラ-CRTM



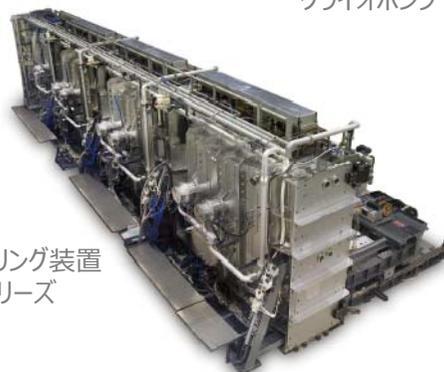
クライオポンプ



スパッタリング
ターゲット材料
(IGZO)



P-CVD装置
CMDシリーズ



スパッタリング装置
SMDシリーズ



スパッタリング用DC電源

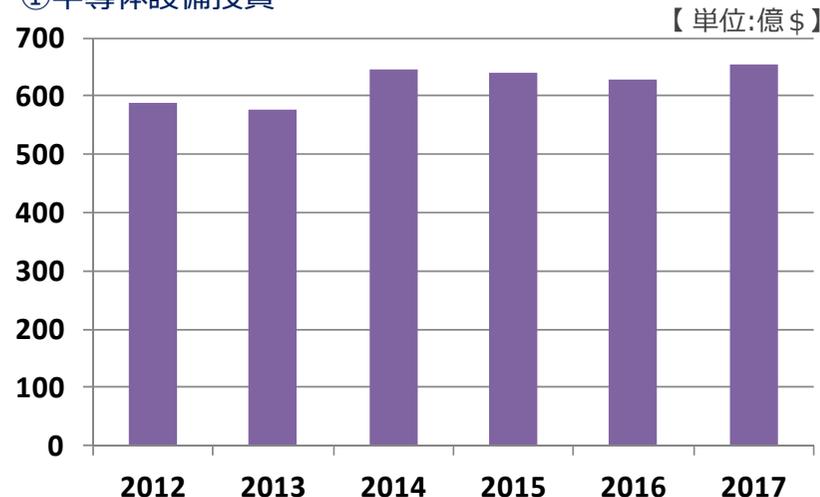


タッチパネル
ディスプレイ製造装置
STDシリーズ

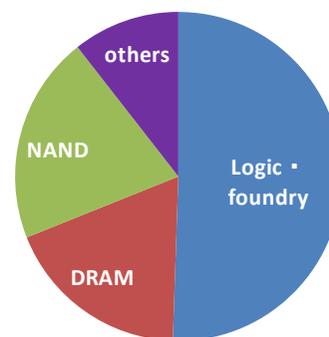
半導体製造装置市場とアルバックの取組み

- ・半導体設備投資は、概ね堅調に推移。
- ・投資の中心は、ロジック・ファウンドリーとNAND、不揮発性メモリが占める。

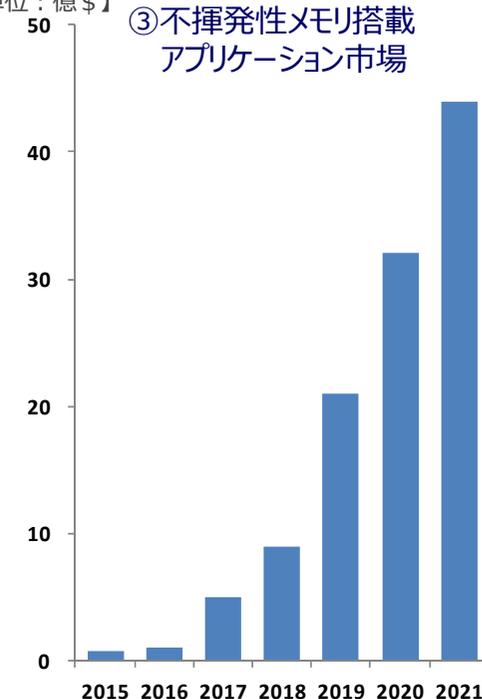
①半導体設備投資



②半導体設備投資額の内訳



【単位: 億\$】



<①・②Gartner資料、③Yole Development資料から作成>

NAND (3D含む) 及び DRAMメモリ	NAND・DRAMメモリは、当社の実績がある市場。特にNANDは、今後大型投資も予想されており、確実に市場を確保する。
次世代不揮発性メモリ	将来的に、大きな伸びが期待できる市場。当社の実績を生かしナンバー1を目指す。
ロジック・ファウンドリー	顧客のニーズに合わせた装置、プロセスを提供し、参入を図る。

電子部品製造装置とアルバックの取組み

- ・高機能化、薄型化等に伴う、顧客ニーズに合わせた装置を提供。
- ・IoT全般において社会に貢献。

分野	顧客ニーズ	当社装置
パワーデバイス	Si薄ウエハ・ SiC/GaN 各社ニーズ への対応	スパッタ装置 イオン注入装置
PCB実装	角型フレキ シブル基板 への対応	スパッタ装置 アッシング装置
WLP実装	高密度化	アッシング装置
電子デバイス 通信デバイス MEMS	小型化 高機能化	スパッタ装置 エッチング装置 プラズマCVD装置

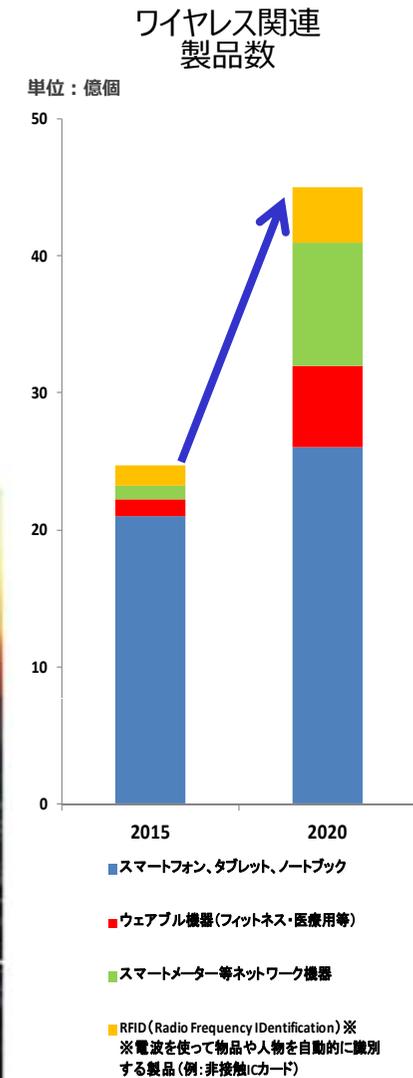
各分野とも、今後の成長が見込まれる
(例) PCB実装製品市場



<Yole Developpement 資料より>

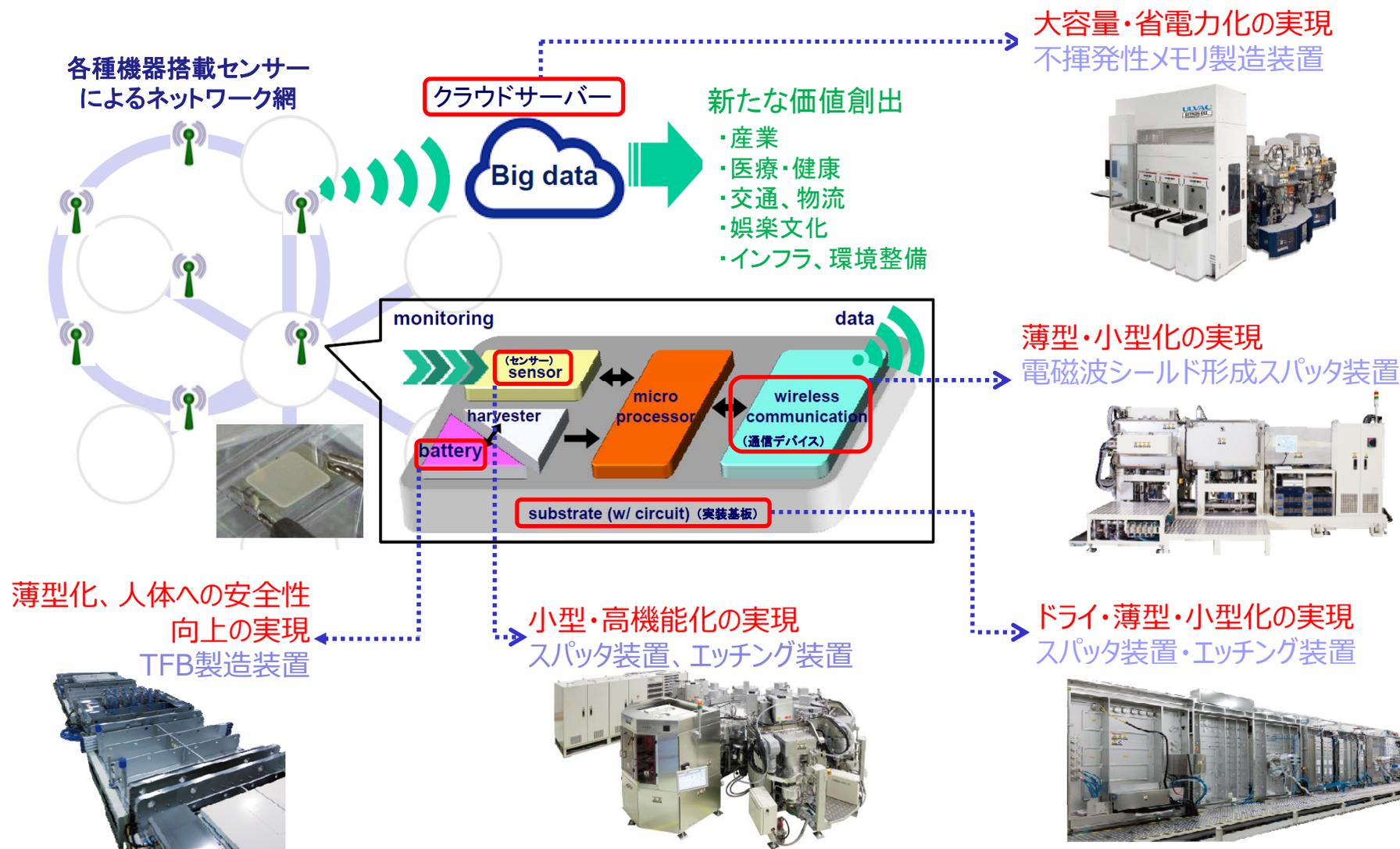
あらゆるモノがインターネットにつながる世界
ワイヤレス関連製品の需要は大幅に増加

The Internet of Things IoT



<ID Tech資料から作成>

IoTに活かされるアルバックの真空技術



真空テクノロジーで
「つくる」をつくる、アルバック
ULVAC

本日は
ありがとうございました